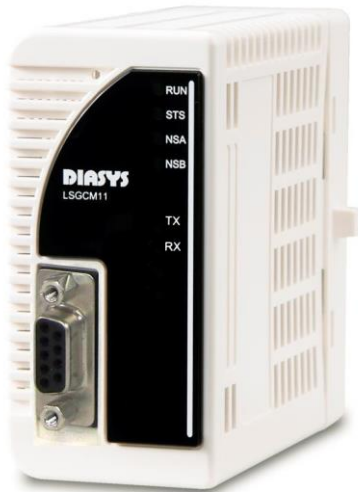


# LSGCM11 Profibus (RS485) 通信モジュール

LS communication Profibus (RS485) 1ch

## ■概要



- \*通信ポート : 1点
- \*モジュール周囲温度範囲 : -5~60°C

# LSGCM11 Profibus (RS485) 通信モジュール

LS communication Profibus (RS485) 1ch

## ■ 定格/性能

項目		定格/性能
通信ポート	点数	1点
	通信速度	9.6kbps, 19.2kbps, 93.75kbps, 187.5kbps, 0.5Mbps, 1.5Mbps, 12Mbps
	通信サイズ	・定周期データ 最大244byte / 台 全SLAVE機器からのプロセス入力:最大5712byte 全SLAVE機器へのプロセス出力:最大5760byte ・非周期データ(DIAG, ALARM) 最大240byte / 台
	通信方式	ハイブリッド方式(トークンパッシング方式とマスタ/スレーブ通信方式)
	SLAVE機器接続台数	最大125台※ <sup>1</sup>
	動作モード	マスターモード
	サポートプロトコル	DP-V0, DP-V1 Class1
	登録コマンド数	・定周期通信:最大125コマンド※ <sup>1</sup> ・DIAG, ALARM 受信用:それぞれ最大125コマンド※ <sup>1</sup>
	PROFIBUS通信ID	GCM(MASTER)側通信IDは1とする。※ <sup>2</sup>
2重化対応	可(2台設置、CPUのApplication Logicにてデータ選択)※ <sup>3</sup>	
絶縁耐圧	DC500V	
IOA間通信仕様	通信方式	LVDS
	通信速度	100Mbps
自己診断機能		電源チェック (24V, 3.3V, 1.5V, 1.2V) クロックチェック (FPGA—診断用MCU、診断用MCU—FPGA) ハートビートチェック (FPGA⇒診断用MCU、診断用MCU⇒FPGA、FPGA⇒通信用MCU) CRCチェック (FPGA) 例外割り込みチェック (通信用MCU) 通信設定ファイルチェック (通信用MCU) 上位計算機(DPS, MPSなど)とのコネクションチェック (通信用MCU)
保護機能	(供給電源保護)	過電圧、過電流保護
インジケータ	状態表示LED	4点 RUN(Run) / STS(Status) / NSA(Network status A) / NSB(Network status B)
	通信状態表示LED	2点 TXD(CH1 TXD Status) / RXD(CH1 RXD Status)
ホットスワップ(活線挿抜)		可
供給電源		DC24V ±20% (バックプレーンから供給を受ける電圧)
環境条件	モジュール周囲温度	(動作時) -5~60℃ (保管時) -40~85℃
	モジュール周囲湿度	(動作時/保管時)10~95%RH (結露なきこと)
耐振動		3.5mm @ 5 Hz ~ 8.4 Hz 1G @ 8.4 Hz ~ 150 Hz
耐衝撃		15G 11ms
消費電流		150mA以下
重量		170g
外形寸法		97mmD x 94mmH x 46mmW (突起部除く)
準拠規格/準拠指令		EN 61131-2-2007, RoHS

適合モジュール型式について:

- ・本製品の適合バックプレーンについては、「適合バックプレーン一覧(CGS-S9901-J-XX)」をご参照ください。
- ・本製品の適合アクセサリコネクタについては、「適合アクセサリコネクタ一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

※<sup>1</sup> システム環境によっては、通信周期を落とすなどの調整が必要となります。

※<sup>2</sup> モジュール 2 重化時の通信 ID は制御側を 1、待機側を 0 とします。

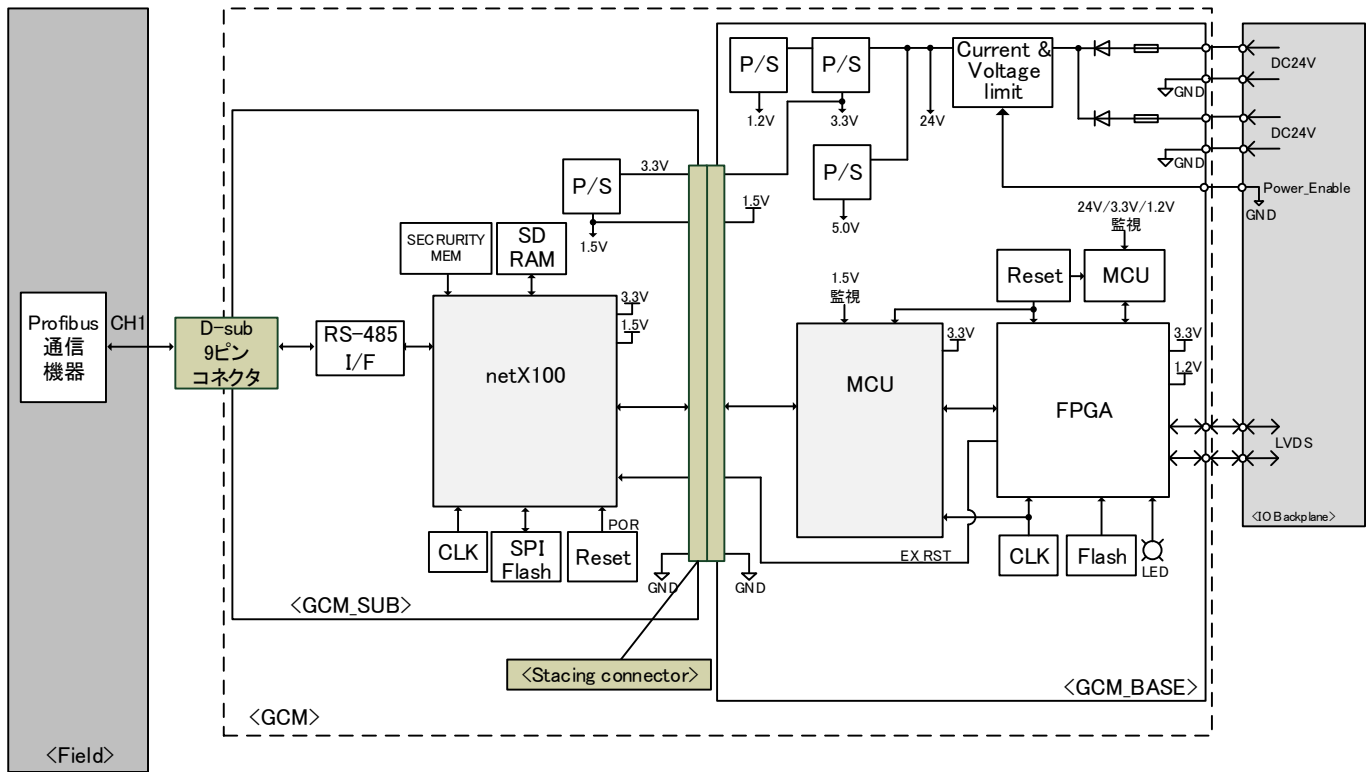
※<sup>3</sup> 本モジュールを 2 重化する場合は、シングル対応のバックプレーン(LSIOB01/LSIOB01-2/LSIOB01-4)を使用してください。



- ・本モジュールを 2 台設置し、独立した通信を 2 回線確立のうえ、上位系の Application Logic にてデータ選択することにより、二重化として使用することができます。

# LSGCM11 Profibus (RS485) 通信モジュール

LS communication Profibus (RS485) 1ch

## ■ブロック図



P/S	:	Power supply
CLK	:	Clock
FPGA	:	Field programmable gate array
LED	:	Light emitting diode
MCU	:	Micro control unit
GND	:	Ground
Serial GNDx	:	Isolation ground
LVDS	:	Low Voltage Differential Signaling
BP	:	BackPlane
	:	fuse
	:	diode

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。  
 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。  
 本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
 DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工業株式会社の登録商標です。  
 文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。